

MSP430 目标板使用说明

(Ver1.5 Release 2010.05.25)

功能:

用户根据需要提供开发测试所有 20pin、28pin、64 pin、100pin 的 MSP430 最小系统板,可配合我们的 MSP430 JTAG、MSP430 BSL、MSP430 U-JTAG、PRGS430 Pro 以及 TI 原厂的各种开发工具一起使用。

特点:

适合开发 MSP430 FLASH 系列 20pin、28pin、64 pin、100pin 单片机的用户,成本低,芯片直接焊接在目标板上,将所有引脚都引出,并提供单独的 JTAG 口和 BSL 口、外部供电接口,完全兼容德州仪器原厂 PM64 目标板、PM100 目标板,并增加对 PW20 和 PW28 封装芯片的支持,JTAG 接口增加 BSL 编程功能,以便更好地配合我们开发的 PRGS430 编程器,使用我们的编程器可以直接使用 JTAG 接口或 BSL 接口,而不需要更换接口线和制作接品转接线。

MSP430 目标板上已焊接基本电路,用户无须增加任何器件及可调试、运行程序。 MSP430 目标板上焊接有一个 LED 显示灯、作为测试使用,当该 IO 口做其它功能使用时, 断开 MSP430 目标板上的跳线即可。MSP430 目标板上已焊接 32.768K 低速晶振,满足一般 应用需求,用户若要使用高速晶振,可直接更换高速晶振即可。

MSP430目标板支持芯片型号: MSP430F13x、MSP430F14x、MSP430F15x、MSP430F16x、MSP430F41x 、 MSP430FE42x 、 MSP430FW42x 、 MSP430FG43x 、 MSP430F44x 、 MSP430FG46xx、MSP430F1xx、MSP430F21xx 等系列单片机,支持所有 PW20、PW28、TQFP64、TQFP100 封装的芯片。

MSP430 目标板支持兼容 TI 提供的所有程序,测试程序可以从本站资料中下载。 注意:

- 1、对于 PW20 和 PW28 封装芯片,芯片引出脚未按顺序排列,引出位置请查看 MSP430 目标板电路图。
- 2、若用户自行更换芯片,请参考电路图中电阻 R5~R10 焊接情况,如果未按要求焊接将造成 BSL 接口不可用,我们出厂时已焊接好对应芯片的电阻。





http:www.hz430.com

MSP430 目标板

